

关键指标

频率：2~6GHz
增益：26dB
1dB 压缩点输出功率：26/27dBm
电压/电流：+5V/240mA, +6V/240mA
芯片尺寸：1.55mm×1.6mm

产品简介

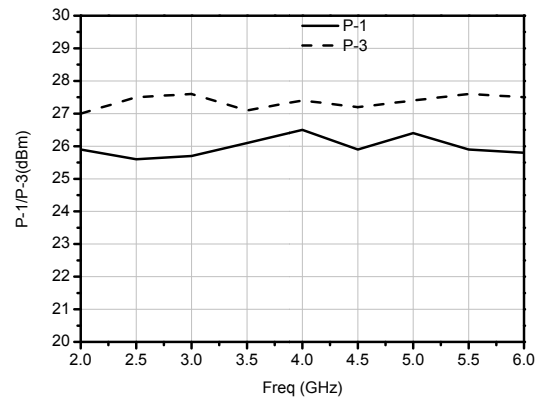
HG124F6 是一款 2~6GHz 驱动放大器芯片, 增益为 26dB, 1dB 压缩点输出功率为 26/27dBm。

电性能

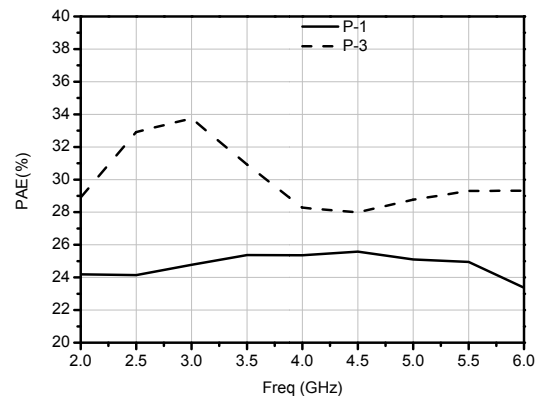
($T_A=25^{\circ}\text{C}$, $V_{dd}=5\text{V}$, $V_G=-0.67\text{V}$; $V_{dd}=6\text{V}$, $V_G=-0.72\text{V}$)

指标	最小值	典型值	最大值
频率(GHz)	2~6		
增益(dB)	-	26	-
增益平坦度(dB)	-	±1.5	-
输入驻波	-	1.2	-
输出驻波	-	1.4	-
1dB 压缩点输出功率(dBm)	-	26/27	-
3dB 压缩点输出功率(dBm)	-	19/24	-
静态电流 (mA)	-	240	-

1dB/3dB 压缩点输出功率

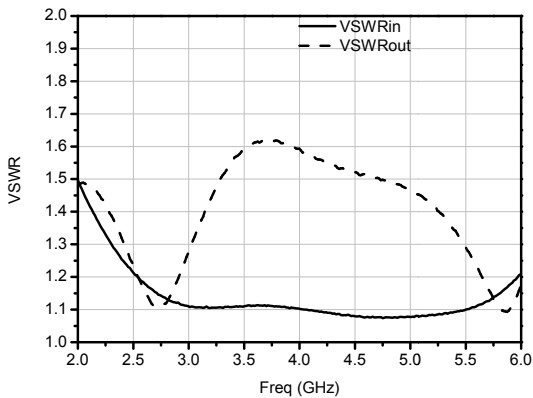


功率附加效率

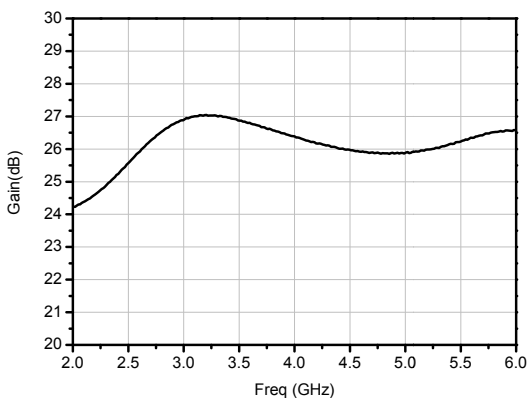


典型测试曲线 (Vdd=5V)

驻波

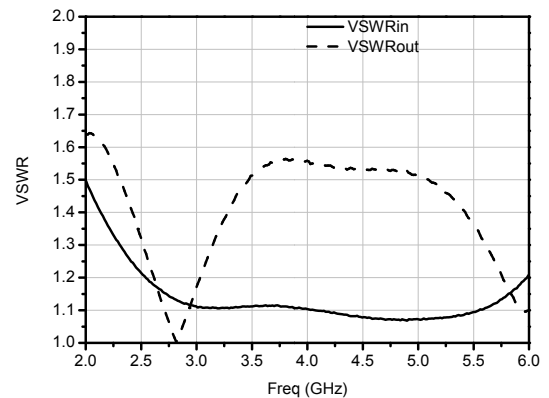


增益

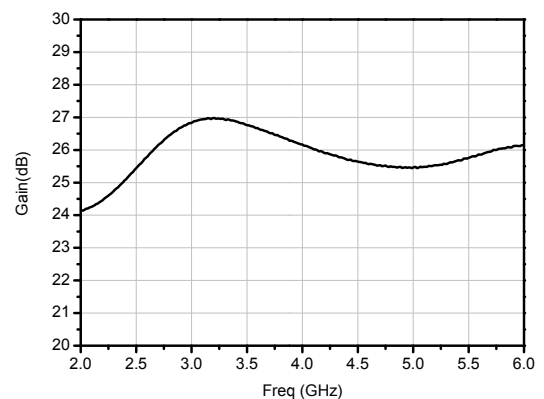


典型测试曲线 (Vdd=6V)

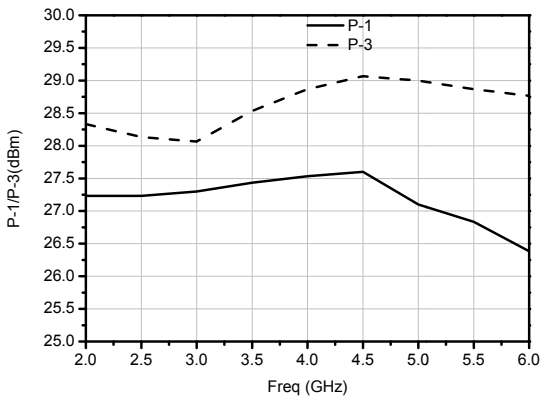
驻波



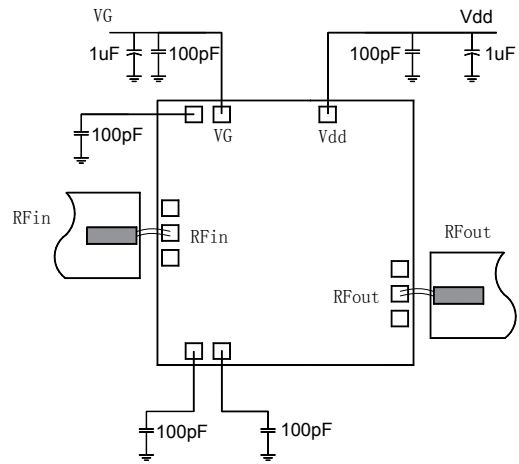
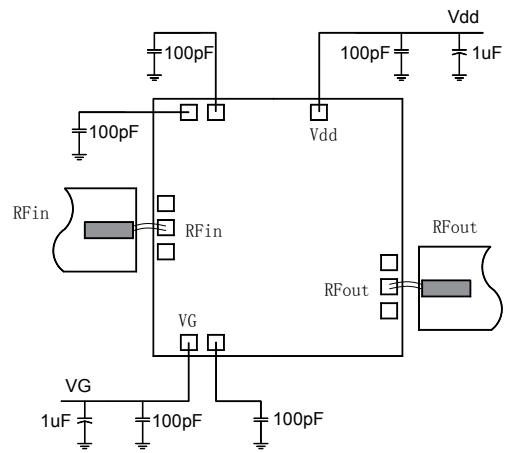
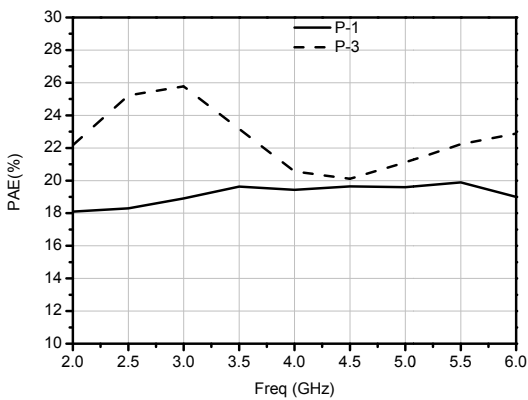
增益



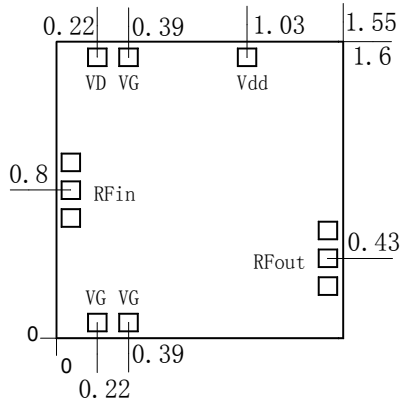
1dB/3dB 压缩点输出功率



功率附加效率



外形和端口尺寸 (mm)



推荐装配图

绝对额定最大值

工作电压	+5.5V
最大输入功率	+20dBm
工作温度	-55℃~125℃
存储温度	-65℃~150℃

注意事项

1. 芯片在干燥、氮气环境中存储，在超净环境使用；
2. GaAs 材料较脆，不能触碰芯片表面，使用时必须小心；
3. 芯片用导电胶或合金烧结（合金温度不能超过 300℃，时间不能超过 30 秒），使之充分接地；
4. 芯片微波端口与基片间隙不超过 0.05mm，使用 Φ25μm 双金丝键合，建议金丝长度 250~400μm；
5. 芯片微波端有隔直电容；
6. 芯片对静电敏感，在储存和使用过程中注意防静电。